



統懋半導體股份有限公司
MOSPEC Semiconductor Company

統懋半導體股份有限公司

法人說明會

股票代號：2434

說明日期：114/12/23





法說會內容

CONTENTS

01. 免責與公司速覽

02. 產品與技術能量

03. 財務概況

04. 市場展望

05. 問答Q&A



免責與公司速覽

01

免責聲明

本簡報資料所提供資訊，包含前瞻性看法。這些前瞻性看法可能因風險、不確定性與假設等的不同狀況而超出我們的判斷，實際結果將可能與此看法有重大出入。由於這些風險、不確定性與假設等的不同狀況，本簡報資料中前瞻性的事件與狀況可能不會依預期發生。讀者不應完全依賴此前瞻性資訊。

統懋半導體股份有限公司(本公司)已儘可能確保本簡報資料為正確無誤且並無遺漏及過時，此外，除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述，且若對本簡報資料任何內容或因倚賴該等內容所採取行動而直接或間接引致之任何損失概不負責。

未經本公司許可的情況下，不可複製、修改、重新編譯刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。



統懋半導體股份有限公司

MOSPEC Semiconductor corp.



設立日期

1987年3月9日



品質認證 ISO

9001/14001/IATF16949



總部 & 生產基地

台南市新市區中山路76號

電話: (06) 599-1621

傳真: (06) 599-1626, 599-5486



大陸子公司

和懋半導體(四川)有限公司

四川省遂寧市經濟開發區

電話: 0825-8095038



台北分公司

台北市敦化南路2段182號16樓之1

電話: (02) 2738-9606

傳真: (02) 2736-9354

公司介紹

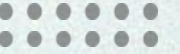
統懋是一家股票在台灣證券交易所掛牌交易的上市公司。公司成立於 1987年，並通過了 ISO 9001、14001 及 ISO/TS 16949 品質認證。自成立以來，一直秉持著創新研究和發展的信念，技術日益精進，促使產品更具競爭力，以滿足客戶的需求。

統懋公司是垂直整合的專業半導體公司，擁有先進技術的電源產品線。主要產品有功率電晶體、蕭特基二極體、超高速和快速恢復整流二極體、突波抑制二極體，以及各種表面黏著型產品元件。

為了服務不同的客戶，統懋提供客戶在各種不同封裝類型產品，如最新的SMD封裝，以及傳統的半導體封裝如 TO-220、TO-247、ITO-220全塑封等產品元件。因此，統懋是一個擁有專業的技術團隊，致力於滿足客戶各種不同特殊需求和提供客戶全方位的完整服務。

發展歷程





產品與技術能量

02

核心產品

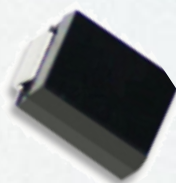
本公司提供六大類高效能半導體元件，廣泛應用於電源管理、高頻切換與電路保護領域。

產品項目	核心優勢	典型應用
蕭特基二極體 (Schottky Diode)	低順向壓降 (VF)、高速開關	開關電源、高頻整流、防反接保護
超快速恢復整流管 (Ultra-Fast Recovery Rectifier)	超短反向恢復時間 (trr)	高頻逆變器、續流二極體、PWM
突波抑制二極體 (T.V.S)	快速響應、高浪湧吸收能力	瞬態過電壓保護、ESD 防護
超低電壓降蕭特基二極體 (Low VF Schottky Diode)	極低 VF，提升系統效率	電池供電設備、低壓 SMPS
功率電晶體 (Power Transistor)	高功率處理能力、放大與開關	電機驅動、電源轉換、功率放大
橋式整流器 (Bridge Rectifier)	將交流電 (AC) 轉換為直流電 (DC)	電源供應器、充電器、變頻器

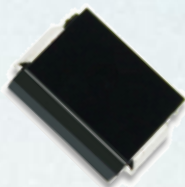
SMA



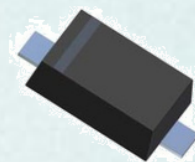
SMB



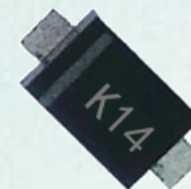
SMC



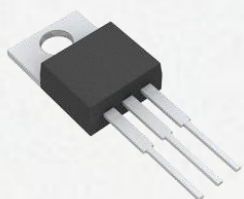
SMF(SOD123)



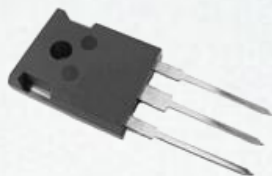
SM6L(SMA Flat)



TO-220



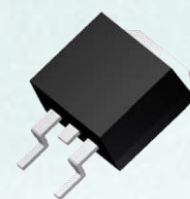
TO-247(S)



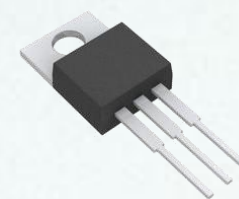
ITO220



D2PAK/TO263



IITO220





財務概況

03

合併資產負債表

單位：新台幣千元

會計項目	114年9月30日		113年12月31日		113年9月30日		兩期差異
	金額	%	金額	%	金額	%	
現金及有價金融商品投資	120,319	18	135,789	19	140,716	19	(20,397)
應收款項	12,206	2	10,471	1	10,394	1	1,812
存貨淨額	6,974	1	7,835	1	7,645	1	(671)
其他流動資產	16,858	2	71,847	10	70,428	10	(53,570)
不動產、廠房及設備	429,212	63	405,372	56	404,477	56	24,735
其他非流動資產	92,935	14	97,959	13	95,361	13	(2,426)
資產總計	678,504	100	729,273	100	729,021	100	(50,517)
應付款項	15,230	2	13,702	2	25,478	3	(10,248)
其他流動負債	1,280	0	1,231	0	1,277	0	3
長短期借款	135,200	20	195,864	27	160,728	23	(25,528)
其他非流動負債	46,212	7	46,212	6	46,212	6	0
負債總計	197,922	29	257,009	35	233,695	32	(35,773)
股東權益總計	480,582	71	472,264	65	495,326	68	(14,744)

合併綜合損益表

單位：新台幣千元

會計項目	114年 前三季		113年 前三季		年成長 金額
	金 額	%	金 額	%	
營業收入	34,527	100	37,801	100	(3,274)
營業成本	(38,359)	(111)	(33,976)	(90)	(4,383)
營業毛(損)利	(3,832)	(11)	3,825	10	(7,657)
營業費用合計	(38,795)	(112)	(39,895)	(105)	1,100
營業利益(損失)	(42,627)	(123)	(36,070)	(95)	(6,557)
營業外收入及支出合計	54,649	158	65,087	172	(10,438)
稅前淨利(損)	12,022	35	29,017	77	(16,995)
本期淨利(損)	12,022	35	29,017	77	(16,995)
基本每股盈餘(虧損)	\$0.32		\$0.78		
加權平均股數(仟股)	37,000		37,000		

產品比重

單位：新台幣千元

產品業務/項目	114年前三季		113年前三季	
	金額(仟元)	百分比(%)	金額(仟元)	百分比(%)
二極體	28,498	82.54	31,378	83.01
電晶體	5,571	16.14	6,127	16.21
其他	458	1.32	296	0.78
合計	34,527	100	37,801	100



市場展望

04

Marketing分析展望

一. 產品行銷策略

1. AI 伺服器電源與車用電子產線布局

- 建構台灣 AI 伺服器電源與車用電子封裝產線，全面提升產能與製造環境。
- 台南廠封裝產線擴建計畫已於 2025 年 1 月起陸續啟動。新增實驗室設備與自動化生產設備，預計於 2026 年第一季（Q1）完成建置並正式啟用。
- 公司以半導體技術起家，於二極體設計領域具備深厚經驗，未來聚焦 高功率零組件，並以 品質至上為核心發展目標。

Marketing分析展望

二. 競爭優勢分析

1. 優良品質與品牌信任

- 長期堅持高品質製程，累積多年技術與製造經驗，建立穩定品牌形象。
- 已通過 ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949 品質認證。

| 註：車用二極體目前正進行車廠認證，現階段營收以小量 SMB 出貨為主。

Marketing分析展望

二. 競爭優勢分析

2. 成熟的製造技術能力

- 持續優化製程，推動生產自動化與製程簡化。
- 在新產品開發與良率控管方面具備成熟經驗。
- 有效降低生產成本，同時提升產品品質與整體營運效益，強化市場競爭力。

Marketing分析展望

二. 競爭優勢分析

3. 完整產品線與市場布局

- 提供多樣化分離式元件，滿足不同用途與規格需求，實現一站式採購。
- 客戶群涵蓋多元電子產業，有效分散單一產業景氣波動風險。
- 擁有完整封裝與測試產線，產品包含：
 - 小信號與 ESD 元件：SOT-363、SOT-323、SOD-123S
 - 功率與整流系列：SMA、SMB、SMC、SMF
 - 功率元件：DO-218、TO-220、TO-247、TO-263、IGBT 等

Marketing分析展望

三. 全球市場拓展與策略合作

1. 海外業務據點布局

- 於 2025 年第二季（Q2）起，在 歐美、日本、韓國 等地設立業務服務據點。
- 透過在地業務資源，積極拓展美洲及歐洲車廠 等國際大廠之合作機會。

Marketing分析展望

2. 策略夥伴與重點客戶進展



統懋半導體
股份有限公司



印度市場

- 預計 2026 年與 現有客戶深化合作 共同切入印度市場，提升工廠稼動率。

日本市場

- 已與在台採購團隊接洽，支援日本 26 座工廠 電子料需求。

韓國市場

- 車門應用電子料導入 SMA 產品，已完成 IMDS 系統資料建立。
- 預計 2026 年 Q2 小量出貨、Q4 正式量產。
- 未來可進一步導入 TVS、DO-218、TO 系列 等車用產品。
- 已建立主要對應窗口，預計於 2026 年 Q1 參訪台南及大陸生產基地。

四. 業務發展方向與營運展望

- 以封裝與測試（封測）生產線調整為首要業務重點，優化產線配置與產能結構。
- 導入標準成本制度，重新檢視產品組合與報價策略，作為業務方向調整依據。
- 預計自2026年第二季（Q2）起，產量將逐步擴張。
- 隨著產能提升與成本結構優化，帶動營業額穩定成長。



問答Q&A

歡迎各位提出相關問題，敬請指教

05



THANK YOU FOR READING!
感謝您的觀看

THANK YOU



說明日期：114/12/23